



國立清華大學專利讓與案公告

(截標日:105/04/13)

有鑑於在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，企業掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積企業技術能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼；國立清華大學擬將其所擁有之優質專利，以讓與方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力及促進整體產業發展，並提昇研發成果運用效益。

- 一、主辦單位：國立清華大學（以下簡稱清華）
- 二、投標廠商資格：國內依中華民國法令組織登記成立之公司法人。
- 三、專利標的：專利明細請詳附件。

詳細資料請參考清華大學產學合作營運總中心（OCIC）網站

<http://ocic.nthu.edu.tw/ocic>。

四、投標方法：

1. 採通訊或親送方式投標，投標廠商應按標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商印信（公司大小章），連同押標金、廠商基本資料表、設立文件：如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本，裝入信封密封之，並在信封上註明“國立清華大學發明專利讓與案投標”，並於 105 年 04 月 13 日下午 5 時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：

30013 新竹市光復路二段 101 號

國立清華大學 智財技轉組 收

2. 投標廠商重複投標者，投標廠商之全部投標均視為無效。
3. 投標後除清華要求或同意外，投標廠商不得以任何理由要求撤回或修改其投標單。
4. 投標廠商於投標時，不得附加任何成交條件。如附加任何成交條件者，視為無效投標，無效之投標不進入決標程序。



五、 押標金：

1. 押標金為總投標價格之 10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「國立清華大學」。
3. 押標金需連同投標單於截標日 105 年 04 月 13 日（含）下午 5 時整（含）前一併掛號寄達或親送至清華，否則其投標視為無效；若有不足者，清華得要求投標廠商補足。若於決標前未能補足者，視為其投標無效。
4. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

六、 決標方法：

1. 開標時間為 105 年 04 月 14 日。
2. 開標時，先審查及確認投標資格、投標文件、押標金是否符合公告內容。
3. 投標廠商之資格及評審項目以外資料經審查合格者，其所提企劃書由本校成立評審小組，依招標文件規定辦理書面評審。
4. 評審作業：
 - i. 投標文件經審查合於招標文件規定者，始得為協商及評審之對象。
 - ii. 評審小組以書面審查進行評分，必要時得通知符合本案招標文件規定之廠商前來說明或簡報。
5. 同一案以總評分最高者得標。
6. 同一案有二個（含）以上總評分相同時，以出價最高且高於底價者得標，投標廠商不得異議。
7. 開標時將請律師到場監標。



8. 開標後將個別通知投標廠商開標結果(不公告得標廠商)。
9. 對於流標、廢標或無效投標之專利標的，清華得逕洽第三人為讓與等交易行為。

七、 契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起 10 個工作天內，與清華簽訂「專利讓與契約書」。
2. 得標廠商如屆時未與清華簽訂「專利讓與契約書」或未繳清應付款項時，清華得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經清華同意者，不在此限）；此外，清華得另洽第三人為讓與等交易行為，得標廠商不得異議。
3. 得標廠商與簽訂「專利讓與契約書」者，需為同一人，否則清華得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，清華得另洽第三人為讓與等交易行為，得標廠商不得異議。
4. 得標廠商簽署「專利讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「專利讓與契約書」之讓與價金。
5. 「專利讓與契約書」自雙方依法簽章後生效。
6. 專利相關登記手續，由得標廠商負責向經濟部智慧財產局或各國智權主管機關提出申請，並負擔因相關手續所需之費用（包括但不限於規費、律師費等）。
7. 得標廠商將遵守國家法律與經濟部暨所屬相關主管機關之法規、命令(包括但不限於境外實施等規定)。前述法令變動時，亦同。
8. 得標廠商同意其對於專利標的若有自行實施或授權或轉讓與第三人於大陸地區或其他我國管轄區域外等，應檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之情事，並遵守相關之法令規定自行向主管機關為必要之申請或取得核准及同意。
9. 得標廠商將就專利標的，授予清華永久享有無償、全球、非專屬及不可轉讓之實施權利。此外，於簽署「專利讓與契約書」前，若清華已分別就專利標的之一部或全部與第三人簽訂授權契約者，或對第三人為不主張權利之承諾者，得標廠



商同意容忍清華對相關特定人之授權，且於清華前揭授權有效範圍內，不對該相關特定人依據專利標的行使專利權。得標廠商嗣後若將專利標的專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。

10.得標廠商應自「專利讓與契約書」生效之日起負擔專利標的之申請、答辯、維護等相關費用；「專利讓與契約書」生效日前之專利標的之申請、答辯、維護等相關費用由清華負擔。得標廠商未依規定自行繳費，致專利標的失效或發生其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，清華毋須為得標廠商之利益支付任何維護專利之相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務，亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。

11.得標廠商同意並承認，「專利讓與契約書」僅為清華同意讓與專利標的予得標廠商。清華亦僅依本標案公告日之專利現狀辦理本標案並讓與專利標的予得標廠商，清華不擔保專利標的之申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或獲證專利權不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更等。清華亦不擔保專利標的無瑕疵、不擔保專利標的得向第三人主張權利或請求損害賠償、不擔保專利標的之合用性或商品化之可能性，且不擔保得標廠商利用專利標的技術所製造產品之產品責任。得標廠商或第三人因專利標的發生任何損害時，得標廠商同意清華無須負擔任何責任，包括相關侵權與瑕疵擔保責任。

「專利讓與契約書」生效後，專利標的之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與清華無涉；清華亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，清華並無提供任何有關專利標的之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關專利標的之諮詢講解或訓練之義務。

12.基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之第三人（以下簡稱本國廠商）就專利標的主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該本國廠商請求協商授權或讓與事宜。

13.得標廠商如為技術服務業者，應自簽署「專利讓與契約書」且生效日起三年內，不以專利標的對本國廠商提起專利侵權



訴訟。上述期間內得標廠商對本國廠商主張權利時，應依前述第 12 點前段約定並應採授權或讓與為優先方式。得標廠商嗣後若將專利標的專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。

八、 注意事項：

投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、標單、專利標的及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或抵觸者，清華保留最終之解釋與決定權利。

九、 領標方式：

有意投標者，請與清華大學產學合作營運總中心聯絡人(請見十、聯絡方式) 連絡。

十、 聯絡方式：

公告／招標等問題請洽清華大學產學合作營運總中心聯絡人

國立清華大學 智財技轉組

電話：+886-3-516-2300，傳真：+886-3-571-9649

電子信箱：stma@mx.nthu.edu.tw

地址： 30013 新竹市光復路二段 101 號



附件：專利讓與清單明細（共 39 個家族，49 件專利）

序號	家族編號	國別	證書號	計畫類別	技術領域
1	I4P94003-TW	中華民國	I267231	科技部	機械結構、電子電機
2	I4P94003-US	美國	7,394,335	科技部	機械結構、電子電機
3	I4P94022-TW	中華民國	I267226	科技部	電子電機
4	I4P94022-US	美國	7,369,011	科技部	電子電機
5	I4P98139-CN	大陸	388286	科技部	材料化工、電子電機
6	I4P98139-TW	中華民國	I272730	科技部	材料化工、電子電機
7	I4P98139-US	美國	7,012,016	科技部	材料化工、電子電機
8	J2P92004-TW	中華民國	I225576	科技部	資訊工程、電子電機
9	J2P92036-TW	中華民國	I230760	科技部	機械結構、電子電機
10	J2P92036-US	美國	7,189,359	科技部	機械結構、電子電機
11	J2P96041-JP	日本	4824710	科技部	材料化工
12	J2P99169-JP	日本	5134132	教育部	材料化工
13	J3P91011-TW	中華民國	I246449	科技部	機械結構
14	J3P91011-US	美國	6,872,662	科技部	機械結構
15	J3P93014-TW	中華民國	I230683	科技部	機械結構
16	J3P94041-TW	中華民國	I261572	科技部	機械結構
17	J3P94042-TW	中華民國	I292337	科技部	機械結構
18	J3P94042-US	美國	7,794,136	科技部	機械結構
19	J3P94048-TW	中華民國	I235906	無計畫	機械結構
20	J3P95001-TW	中華民國	I274856	科技部	機械結構、生化醫藥
21	J3P95004-TW	中華民國	I303302	無計畫	機械結構
22	J3P96008-TW	中華民國	I268804	科技部	機械結構
23	J3P96047-TW	中華民國	I290483	科技部	機械結構
24	J3P97008-TW	中華民國	I296326	科技部	機械結構
25	J3P97020-TW	中華民國	I269749	無計畫	機械結構
26	J3P97030-TW	中華民國	I226934	科技部	機械結構
27	J3P97052-US	美國	8,297,765	科技部	機械結構、光電光學
28	J3P97068-US	美國	6,909,998	科技部	工業工程
29	J3P97083-TW	中華民國	M345214	無計畫	機械結構
30	J3P98126-TW	中華民國	I350370	科技部	機械結構、生化醫藥
31	J3P98127-TW	中華民國	I336401	科技部	機械結構、生化醫藥
32	J3P98128-TW	中華民國	I346780	科技部	機械結構、生化醫藥
33	J6P91013-TW	中華民國	I229343	科技部	資訊工程
34	J6P91013-US	美國	6,873,557	科技部	資訊工程
35	J6P91015-TW	中華民國	I228349	科技部	電子電機、資訊工程
36	J6P91015-US	美國	6,791,387	科技部	電子電機、資訊工程
37	J6P92009-TW	中華民國	195155	科技部	資訊工程
38	J6P92025-TW	中華民國	179375	科技部	電子電機



39	J6P94029-TW	中華民國	I297825	無計畫	電子電機
40	J8P93029-TW	中華民國	I235041	科技部	資訊工程
41	J8P93029-US	美國	7,561,726	科技部	資訊工程
42	J8P95005-TW	中華民國	I330773	無計畫	機械結構
43	J8P99215-TW	中華民國	M417382	無計畫	工業工程
44	JAP94018-TW	中華民國	I232845	科技部	電子電機
45	K3P93012-TW	中華民國	182739	科技部	生化醫藥
46	K3P93045-TW	中華民國	203620	科技部	機械結構、材料化工
47	K3P93046-TW	中華民國	I225246	科技部	光電光學
48	K5P92010-US	美國	6,921,902	無計畫	生化醫藥
49	V9P98009-US	美國	8,222,487	科技部	生化醫藥
50	J3P95056-TW	中華民國	200196	無計畫	機械結構
51	J2P92014-TW	中華民國	160991	科技部	生化醫藥